可焊性指，在一定条件下，焊料与焊接面的可浸润的难易程度。电路板可焊性主要由7个方面综合评价：1、焊料、助焊剂的特性和要求。2、电路板的特性和要求。3、连接线缆的特性和要求。4、直插安装及表面安装元器件的特性和要求。5、电路板残留物清洗要求。6、涂层要求。7、返工返修要求。

1. STD-001

IPC-HDBK-001